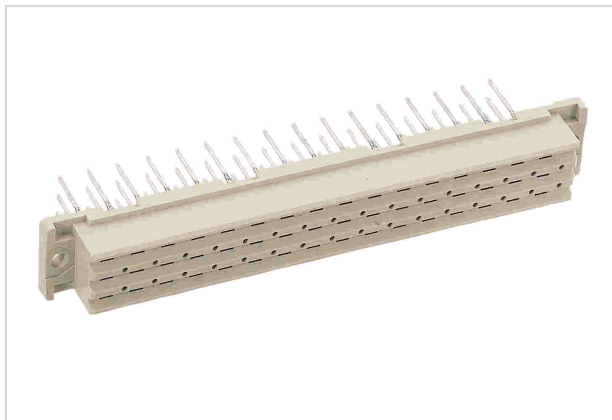


DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 06 248 6837
Beschreibung	DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09062486837

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	DIN 41612
Bezeichnung	Bauform F
Komponente	Federleiste
Kontaktbeschreibung	gerade
Merkmale	bleifrei

Ausführung

Anschlussart	Einpressanschluss Wickelanschluss
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard Mezzanine
Kontaktanzahl	48
Kontaktbestückung	Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
Länge der Pins	13 mm
Kodierung	Loch-Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung	mit Flansch

Technische Kennwerte

Steckkontaktreihen	3
Raster, anschlussseitig	3,81 mm 5,08 mm
Raster, steckseitig	3,81 mm 5,08 mm



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsstrom	Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke	≥1,6 mm
Kriechstrecke	≥3 mm
Isolationswiderstand	>10 ¹² Ω
Durchgangswiderstand	≤15 mΩ
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte
Steck- und Ziehkraft	≤75 N
Anforderungsstufe	2 nach IEC 60603-2
Steckzyklen	≥400
Prüfspannung U _{eff}	1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
Isolierstoffgruppe	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke	≥1,6 mm
Hot plugging	nein

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni steckseitig Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

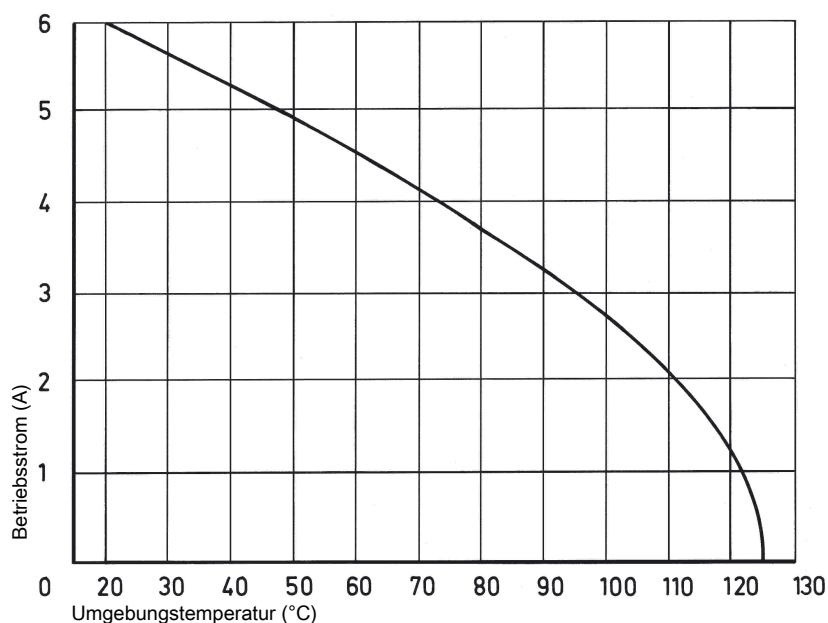
Normen	IEC 60603-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung	F4/I3 gemäß NFF 16-101/102

Kaufmännische Daten

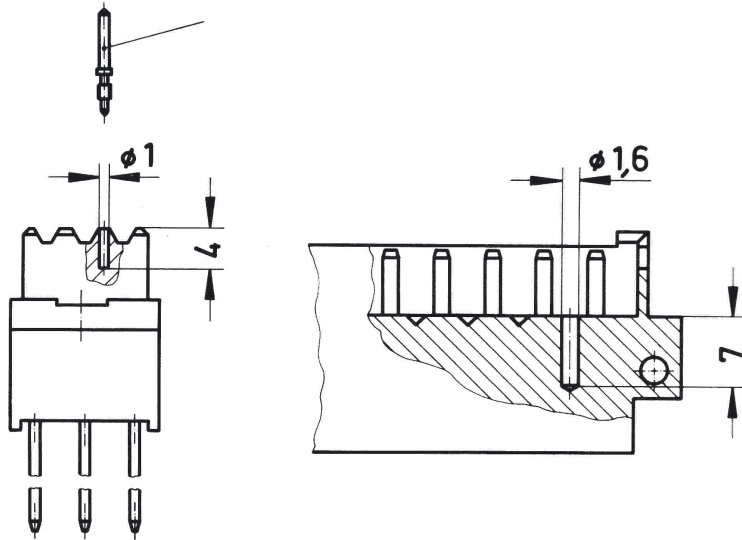
Packungsgröße	20
Nettogewicht	18,24 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140013933
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

Derating Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.
Mess- und Prüfverfahren nach IEC 60512-5-2

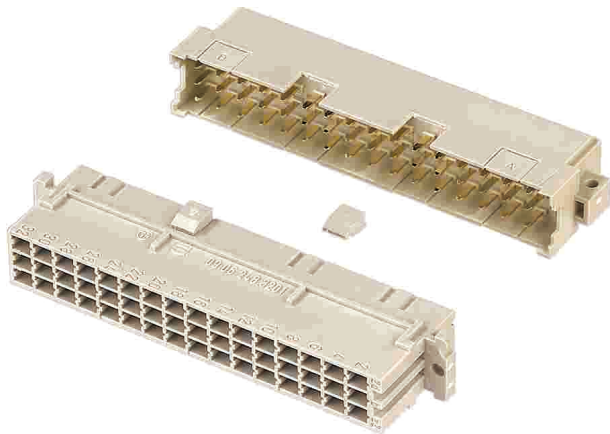


Loch-Kodierung (ohne Kontaktverlust)



Zur Unverwechselbarkeit mehrerer Steckverbinder nebeneinander ist eine Kodierung erforderlich. Messerleiste an vorzentrierter Stelle nach Skizze aufbohren. In Federleiste Kodierstift 09 06 000 9950 mit Setzwerkzeug 09 99 000 0103 in vorhandene Bohrung einsetzen.

Kragen-Kodierung (ohne Kontaktverlust)



Zur Unverwechselbarkeit mehrerer Steckverbinder nebeneinander ist eine Kodierung erforderlich. Den Kodierstift 09 06 001 9919 in der Federleiste nach Skizze einstecken. Die korrespondierende Ausnehmung am Messerleistenkragen ausbrechen. Die Steckverbinder mit Kodierung lassen sich im Einschubrahmen im Raster $\geq 20,32$ mm montieren.

Kodierung mit Kontaktverlust

Zur Unverwechselbarkeit mehrerer Steckverbinder nebeneinander ist eine Kodierung erforderlich.

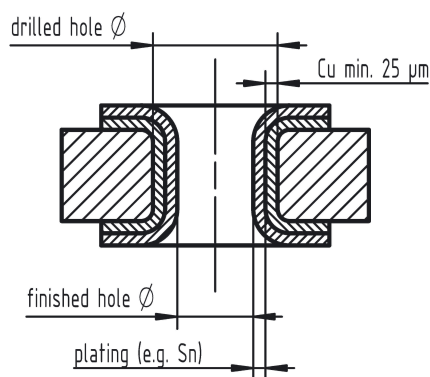
Eine Kodierung wird durch das Einsetzen eines Kodierteiles an die gewünschte Kontaktstelle – mit Kontaktfeder – in der Federleiste erreicht.

Das korrespondierende Messer muss mit dem Abdrehwerkzeug abgedreht werden. Es wird empfohlen mindestens 3 Kodierteile zu verwenden.

Kodierstift 09 04 000 9908

Abdrehwerkzeug für Messerkontakte 09 99 000 0038

Empfohlener Lochaufbau der Leiterplatte



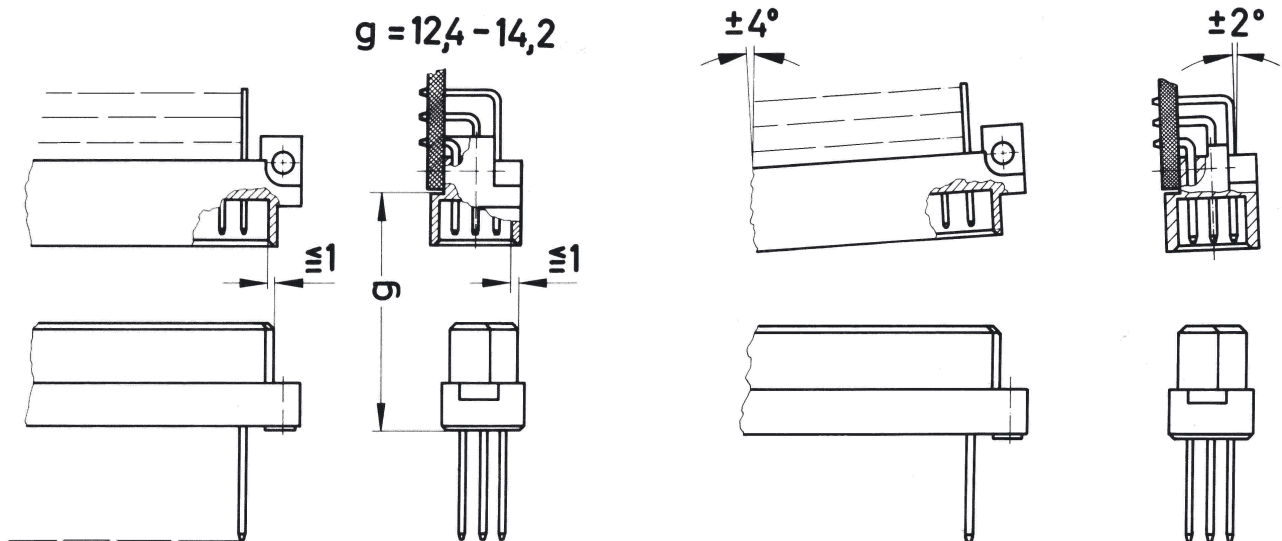
Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	max. 15 µm
	plated hole Ø	0,94 – 1,09 mm
Chemical tin plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Sn	min. 0,8µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Gold /Nickel plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ni	3 – 7 µm
	Au	0,05 – 0,12 µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Silver plated PCB	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	Ag	0,1 – 0,3 µm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm
Copper plated PCB (OSP)	Drilled hole Ø	1,15±0,025 mm
	plated hole Ø	1,00 – 1,10 mm

Neben der Hot-Air-Level (HAL) Leiterplattenoberfläche werden neue Oberflächen immer bedeutender. Aufgrund ihrer anderen mechanischen Eigenschaften, z. B. Festigkeit und Reibkoeffizient, empfehlen wir die oben genannten Lochaufbauten.

Montageanleitung

Es wird dringend empfohlen, HARTING Einpresswerkzeuge zu verwenden, um einen zuverlässigen Einpressvorgang zu gewährleisten. Werkzeuge, Maschinen und weitere Informationen zum Einpressvorgang entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Steckbedingungen



Um eine sichere Kontaktgabe zu gewährleisten und ein Beschädigen der Steckverbinder zu verhindern, sind nachfolgende Einbauhinweise zu beachten.

Diese Steckbedingungen entsprechen IEC 60603-2.

Die Steckverbinder sollen nur spannungslos betätigt werden.